

株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日

配当金受領 期末配当金：3月31日
株主確定日 中間配当金：9月30日

単元株式数 100株

定時株主総会 毎年6月

公告方法 電子公告 (<https://www.fujimiinc.co.jp>)
ただし、事故その他やむを得ない事情によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。

株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

郵便物送付先及び電話照会先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-232-711 (通話無料)

各種手続のお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
- 住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等については、証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。
なお、証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社へお申出ください。

株式会社フジミンコーポレーテッド

お問い合わせ先：経営企画部経営企画課
TEL：052-503-8181 (代表)
URL：<https://www.fujimiinc.co.jp>

Copyright (C) 2025 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

株式会社フジミンコーポレーテッド 株主通信

FUJIMI TODAY vol.60

2024.4.1 ~ 2025.3.31

2025年6月発行

特集

フジミの製品が使用されるシーン

技術を磨き、心をつなぐ

FUJIMI

証券コード 5384



お客様目線の実践

パウダー&サーフェスカンパニーへの進化

「働きがい」と「働きやすさ」の醸成

当事者意識とやり抜く力の確立

革新への挑戦

UD FONT
by MORISAWA



この印刷物は、適切に管理された森林で生産された木材を使った環境配慮型のFSC®認証紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しております。



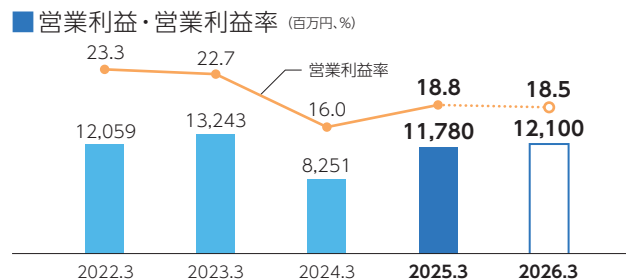
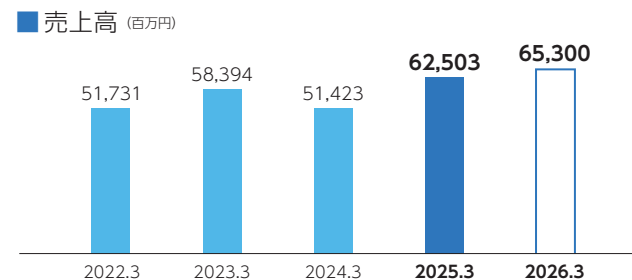
技術を磨き、心をつなぐ

私たちの「磨く技術」は半導体をはじめとしたさまざまな産業で活かされています。フジミはお客様にあらゆる製品を磨いていただくことで、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

代表取締役社長

関 敬史

連結決算ハイライト ※2026年3月期は予想値



株主の皆様へ

素素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2025年3月期の経営成績

当社グループを取り巻く環境は、世界的な景気後退と地政学リスクへの懸念が高まりました。ロシア・ウクライナ情勢及び中東情勢の緊張状態が継続したことに加え、中国経済の成長率は緩やかに減速し、世界経済の下振れ懸念が続く中、米国政権の動向、とりわけ関税政策に注目が集まり、世界経済の不透明感は強まりました。

世界半導体市場は、AI向け先端半導体デバイスの需要が牽引する一方、パソコンやスマートフォン、車載向け等の需要は力強さを欠いており、全体としては依然バラつきが見られ、本格的な回復には今しばらく時間を要すると思われま。

こうした状況下、当社においては先端半導体向けCMP製品及びシリコンウェハー向け製品の販売が好調に推移したことにより、当連結会計年度の業績は、売上高62,503百万円(前期比21.5%増)、営業利益11,780百万円(前期比42.8%増)、経常利益12,251百万円(前期比36.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益9,428百万円(前期比45.1%増)となりました。

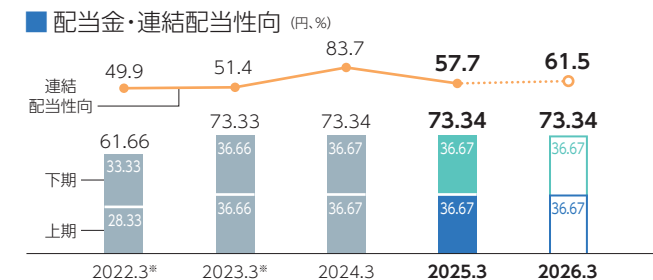
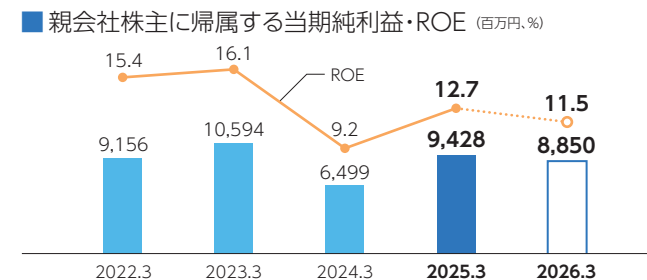
2026年3月期の見通しについて

2026年3月期の見通しにつきましては、世界経済の不透明感が

引き続き強い中で、高価格のAI向け半導体により半導体出荷額は堅調に推移しているものの、パソコンやスマートフォン、車載向け等の需要は力強さを欠いており、半導体生産の本格的な回復には依然時間を要すると見込んでおります。次期は売上高65,300百万円(前期比4.5%増)、営業利益12,100百万円(前期比2.7%増)、経常利益12,100百万円(前期比1.2%減)、親会社株主に帰属する当期純利益8,850百万円(前期比6.1%減)を見込み、配当につきましては、1株につき中間配当金36.67円、期末配当金36.67円とし、年間配当金は当期の73.34円と同額を予定しております。

半導体市場は、中長期的には旺盛な需要が見込まれるため、当社は、将来のさらなる研磨材の需要増加を見据え、積極的に研究開発や設備投資を推進しております。2025年12月末には、岐阜県各務原市に新たな工場(名称:各務山工場、2024年10月着工)を竣工予定です。また、非半導体分野の新規事業の育成・探索を目的に、2025年5月には同じ各務原市内に新たな研究開発センターの建設に着手しました。引き続き設備投資を推し進めるとともに、サステナブルな経営の根幹を成す人への投資やESGに関わる取り組みも積極的に推進してまいります。

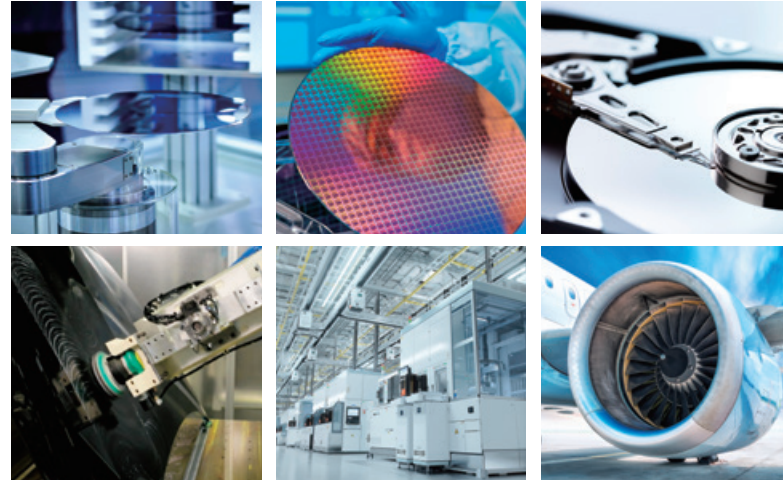
皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。



※当社は、2023年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割を行っております。そのため、2022年・2023年3月期の配当金については、株式分割が行われたと仮定して記載しております。
※配当金は、小数点第3位以下を切り捨てています。

フジミの製品が 使用されるシーン

今回は、普段目に触れることのない当社の製品が、どのような最終製品づくりに使用され、皆様の生活に役立っているかについて、イラストなどを活用しながらご紹介いたします。



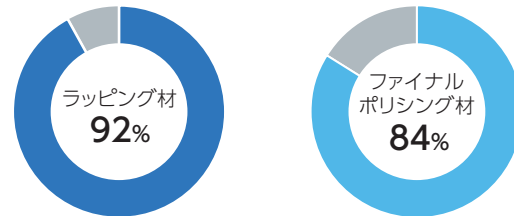
当社は、半導体や電子部品、デジタルカメラ・メガネのレンズ、自動車のボディなどの表面加工に使用される精密人造研磨材メーカーのパイオニアとして、1950年の創業以来独自の歩みを続けています。蓄積されたノウハウと研究開発力から生まれた製品の数々は、シリコンウェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なCMP(化学的機械研磨)、パソコンやサーバーなどの記録媒体であるハードディスク基板の研磨など高精度が求められる先端分野に欠かせません。

当社のシリコンウェハー向け製品では、ラッピング材*、ファイナル

ポリシング材*でいずれも世界シェア8~9割を占めています。

また、半導体デバイスウェハーには多層に微細な配線が施されますが、その配線の平坦化にも当社のCMPスラリー*が使用されます。データ容量、処理能力等はその配線間隔に依存するため、年々配線間隔の微細化が進み、現在では配線間隔が3ナノ(ナノは10億分の1)メートル台のものが量産されています。お客様からの高度な技術要求に応えるにはCMPスラリーの成分の独自設計及び配合や改良が重要で、ここに当社のオリジナリティの高い設計技術とその製品化を可能とする生産技術が力を発揮します。また、お客様

●シリコンウェハー向け研磨材の世界シェア 2025年3月 自社推計

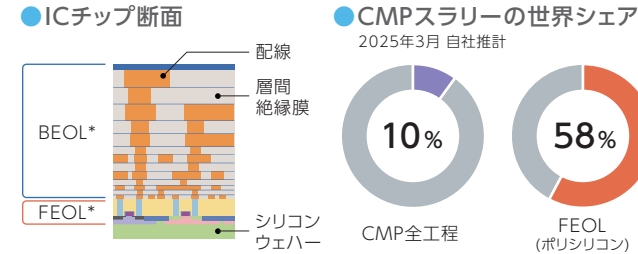


当社製品

研究開発の様子

- ラッピング材… シリコン基板等を粗磨きするための粉末研磨材。
- ポリシング材… ラッピング材よりもさらに細かな砥粒と薬液を配合した鏡面仕上げ用の研磨スラリー(液体研磨材)。
- スラリー… 液体製品。

と同等レベルの研磨装置や評価装置を備え、できる限りお客様と同じ環境で研究開発を進めています。2025年3月時点で、CMPスラリーの世界シェアは約10%と3位グループに位置づけしており、半導体の性能を左右するトランジスタ素子形成工程(FEOL)のポリシリコン向けに限れば、当社は世界シェアの過半を占めます。

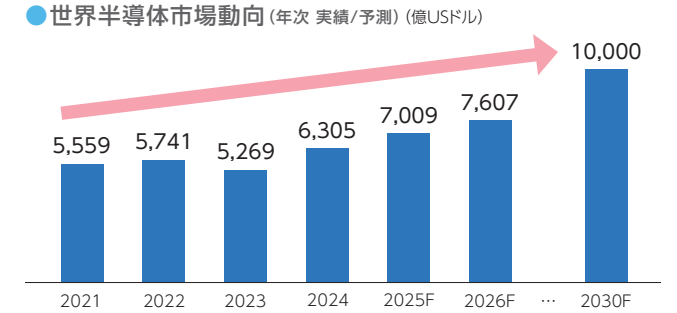


半導体の利用分野は拡大

半導体は、私たちが普段使っている多くの電子機器に搭載されており、日常生活に欠かせないものです。また、急速に進化するAIや自動運転など世界中が注目する最新技術にも半導体は欠かせず、現代と未来のテクノロジーを支える基盤でもあります。

AIや次世代通信などのさまざまな技術に支えられて実現する社会では、自動化や効率化が図られ、家・オフィス・工場、ひいては街全体がスマートに進化します。病院の患者ケア、農作物や水産物の生育監視、ビルの設備管理や自然災害の予兆察知など、幅広い分野でIoT*サービスは普及が進んでいます。

一方で2025年3月時点の半導体市場は、パソコンやスマートフォンの需要が、コロナ特需の反動で本格的な回復に時間を要していることから数量ベースでは足踏みしていますが、金額ベースでは、AI向け半導体デバイスの需要により大きな伸長を示しています。今後も半導体デバイスの用途拡大に伴い、市場の拡大が見込まれ、フジミの技術・製品はますます需要が高まっていくと考えます。新しい社会、より快適な暮らしの実現へ貢献を続けてまいります。



2021~2026F:世界半導体市場統計(WSTS)(2025年6月発表)を基に当社でグラフ作成。
2030F:各種資料を参考に当社でグラフを作成。


- BEOL…… Back End of Lineの略。配線工程。
- FEOL…… Front End of Lineの略。トランジスタ素子形成工程。



- IoT…… Internet of Thingsの略。世の中に存在するさまざまなモノに通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信したりすること。
- コネクテッドカー…… 通信機能を装備した車。
- “考える”家電…… AIやセンサーなどが人に代わって最適な動き方を考え、便利で快適な衣食住を提案する家電。

暮らしの中で使用されているフジミの製品一例

スマートフォン



半導体デバイス (CPU、メモリなど)	
使用される当社製品	ラッピング材: FO、PWA ポリッシング材: GLANZOX、PLANERLITE
水晶振動子・SAWフィルタ部分	
使用される当社製品	ラッピング材: FO、A、PWA、GC ポリッシング材: COMPOL

自動車

ECU (電子制御装置)

エンジンやトランスミッションなどの重要な部分のほか、安全走行のための各種運転支援システムに、半導体デバイス (MCU、メモリ) が搭載

センサー

自車の位置を知るGPSやエアバッグを作動させる圧力センサーなど、自動車に搭載される多数のセンサーの材料として半導体を使用

使用される当社製品	ラッピング材: FO、PWA等 ポリッシング材: GLANZOX、PLANERLITE、COMPOL等
-----------	--

自動車外装

塗装前後のボディ研磨に使う研磨布紙原料

使用される当社製品	ラッピング材: A、WA、GC、C
-----------	-------------------

自動車塗膜の補修研磨

使用される当社製品	コンパウンド研磨材: MIRAFLEX
-----------	---------------------



駆動系部品

エンジンシリンダー、ドライブシャフト、ベアリングを研磨する砥石用原料

使用される当社製品	ラッピング材: A、WA、GC、C
-----------	-------------------

ブレーキパッド

ブレーキパッドのフィラー用材料

使用される当社製品	ラッピング材: WA、C
-----------	--------------

フジミのパウダー技術を活かした溶射材

溶射材とは

研磨分野で培われたパウダー (粉末) の技術を活かし、溶射材の研究開発、製造販売をしています。溶射とは、高温で溶融したセラミックスや金属の微粉を溶射対象物の基材に高速で噴射塗布して、その物の表面を改質する表面加工技術で、基材の耐熱性及び耐摩耗性、耐食性 (耐薬品性) などを飛躍的に高めます。



溶射の方法

溶射材料を溶射ガンに投入し、加熱・加速することで基材へ堆積させて、溶射皮膜が形成されます。




使用領域



半導体・液晶製造装置



鉄道車両部材



自動車部品



鉄鋼



航空機部材



製紙用機械

溶射は基材のメンテナンスサイクルや部品寿命を数倍～数十倍にも延ばす技術として、さまざまな産業用途に適用されています。当社は1998年に溶射材の開発に着手し、2003年より本格的に事業を開始しました。

当社の強みは、材料メーカーでありながら、自社で溶射機や皮膜の評価設備を各種所有し、お客様とできる限り目線を合わせて調査や評価を実施できることにあります。立ち上げ当初は、売上がなかなか伸びず苦戦が続きましたが、自社データを積極的に社外発表するなどして認知度を上げ、当社の強みを活かしたソリューション提案を主軸とした研究開発や営業、たゆまぬ改善を継続した生産活動により、少しずつ当社材料を使用していただけのお客様を増やしてまいりました。今では、品質要求の厳しい航空機部材、自動車部品、半導体・液晶製造装置などでも当社材料を使用した溶射皮膜が適用され、安定した収益が出る事業に成長しております。

溶射は、部材の長寿命化やリユースの観点で環境負荷低減に貢献できる技術としても着目されており、当社は優れた溶射材を提供することで、サステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

新規事業・用途の探索や育成に向けて積極的に展示会へ出展

現在、当社の売上は80%以上が半導体関連ですが、安定的かつ持続的な成長を遂げるために特定の市場や用途に偏ることがない事業構造の構築を目指し、非半導体関連を中心に新規事業・用途の探索・育成に向けて積極的に展示会へ出展しています。

非半導体関連のパウダー(粉)分野では、研究開発している各種(機能性を備えた、形状制御した)セラミックスパウダーや、軽量かつ高い放熱性を備えたセラミックス複合材料、3Dプリンター用超硬材料などを主に紹介しています。サーフェス(表面)分野では、数年前から取り組んでいる自動車外装用の研磨コンパウンドが既に一部大手カーコーティングのお客様に採用されており、さらなる拡販に向けて、海外の展示会にも出展しています。

各展示会で得たお客様のご意見や反応、感触をもとに、研究開発を加速させ、採用拡大や事業化につなげてまいります。



出展した展示会(2024年度下半期)

- 2024年10月…第9回セラミックスジャパン P
- 2024年11月…SEMA SHOW 2024(米国) S
- 2024年12月…SEMICON Japan 2024 S
- 2025年 1月…nano tech 2025 P
- 2025年 3月…SiC,GaN加工技術展 2025 S

P パウダー分野 S サーフェス分野

INFORMATION



将来予想される旺盛な半導体需要に応えるべく、最先端製品の開発・生産・物流施設が集積する岐阜県各務原市に新工場(各務山工場)の竣工を2025年末に予定し建設中で、各務山工場は再生エネルギーを活用するなど環境に配慮するとともに、物流自動化などの最新設備を導入します。また、非半導体関連の事業領域拡大を目指し、中長期視点で取り組む研究開発と新規事業・用途の探索・育成を目的に、新たな研究開発センターを2025年5月に着工しました。

新工場(各務山工場)と第2研究開発センター(仮称)の建設状況

各務山工場		第2研究開発センター(仮称)	
概要	敷地面積 28千㎡ 目的 半導体向け製品の生産能力増強	概要	敷地面積 16千㎡ 目的 非半導体関連の研究開発、新規事業の育成・探索
状況	2024年10月に着工 2025年末に竣工予定 2026年中に試作品出荷予定 2027年中に本格生産開始予定	状況	2025年5月に着工 2026年後半に竣工予定

完成イメージ

2025年4月24日撮影

岐阜県各務原市内

完成イメージ

2025年4月24日撮影

シリコンウェハースイッチング

売上構成比 **32.4%**

売上高(百万円)

前期におけるシリコンウェハースイッチングの生産調整の反動もあり、売上高はラッピング材では7,563百万円(前期比38.2%増)、ポリシング材では12,698百万円(前期比28.1%増)となりました。

CMP用

売上構成比 **49.1%**

売上高(百万円)

先端ロジックデバイスやメモリ向けの販売が増加し、売上高は30,658百万円(前期比11.9%増)となりました。

ディスク用

売上構成比 **4.1%**

売上高(百万円)

データセンター向けHDD(ハードディスクドライブ)の需要増加を受け、売上高は2,547百万円(前期比84.1%増)となりました。

一般工業用・その他

売上構成比 **14.4%**

売上高(百万円)

多種多様な用途向けに研磨材や機能性材料を提供しております。また、半導体装置、航空機及び鉄鋼などさまざまな業界の溶射用途向けに溶射材を提供しております。

当社所属のデフアスリート選手 「東京2025デフリンピック」日本代表に内定

当社所属のデフアスリート中西椋選手と中村美月選手が、「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」の日本代表選手に内定しました。

中西椋選手は男子三段跳、走幅跳に、中村美月選手は女子800m、1500m、4×400mリレーの代表として出場を予定しています。

中西椋選手



中村美月選手



両選手が出場した陸上競技大会結果(直近2大会)

第21回日本デフ陸上競技選手権大会

- 2024年11月29日(金)～12月1日(日)
- 駒沢オリンピック公園陸上競技場(東京都)

中西椋 選手	男子三段跳	1位(記録 13m96cm)
	男子走幅跳	2位(記録 6m27cm)
中村美月 選手	女子1500m	2位(記録 5分08秒81)
	女子800m	2位(記録 2分33秒23)

第22回日本デフ陸上競技選手権大会

- 2025年5月5日(月)～5月6日(火)
- 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場(埼玉県)

中西椋 選手	男子三段跳	1位(記録 14m08cm)
	男子走幅跳	2位(記録 6m28cm)
中村美月 選手	女子1500m	2位(記録 5分03秒62)
	女子800m	2位(記録 2分29秒11)

「東京2025デフリンピック」に トータルサポートメンバーとして協賛

2025年11月に日本で初開催される「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」に、当社はトータルサポートメンバーとして協賛します。

当社社員として勤務するデフアスリートの競技支援はもちろん、参加される選手の皆様が日頃の努力の成果を十分に発揮できるようサポートしてまいります。ぜひ、会場まで足をお運びください。

大会期間	2025年11月15日(土)～11月26日(水)(12日間)
参加者数	各国選手団等 約6,000人
参加国	70～80カ国・地域
大会会場	駒沢オリンピック公園総合運動場、東京体育館ほか

第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025の詳細はこちら

<https://deaflympics2025-games.jp/>

SKシリترون社より ベストパートナーアワードを受賞



2024年11月に、大手半導体シリコンウェハーメーカーである韓国のSKシリترون社よりベストパートナーアワードを受賞しました。2年連続、4度目の受賞となり、同社との緊密な連携のもと、積極的に高品質化に取り組み、製品を確実に供給したことを評価されました。

アジア溶射会議(ATSC2024)でアウト スタンディングリサーチアワードを受賞

2024年12月11日(水)～13日(金)の3日間、東北大学青葉山キャンパスで開催のアジア溶射会議(ATSC2024)に参加し、当社発表の「APS*によるYSZ*-ポリマー複合皮膜の微細構造と熱伝導率」がアウトスタンディングリサーチアワードを受賞しました。

APS

Atmospheric Plasma Spray(大気圧プラズマ溶射)の略。汎用性の高い溶射プロセスの1つで、プラズマアークを通して溶融粉末材料を対象製品の表面に噴霧します。プラズマ放電を発生させて得られる1万℃以上の高温のプラズマジェットで金属または合金を溶かし、対象製品の表面に溶着させます。高融点の材料粉末まで溶融加熱することができるので、金属からセラミックスまで幅広い材料を溶射することが可能です。

YSZ

Yttria-Stabilized Zirconia(イットリア安定化ジルコニア)の略。ジルコニアを元とした酸化物で、酸化イットリウムを添加して、高温下でジルコニアの結晶構造を安定化させたものです。

野村IR資産運用フェア2025に出展

2025年1月9日(木)～28日(火)に、リアル(対面)とオンラインのハイブリッドで開催された野村IR資産運用フェア2025に出展しました。

会期中は、会社の概要や強み、2023年5月発表の中長期経営計画と進捗について説明しました。多くの株主・個人投資家の皆様に当社ブースへお越しいただきました。

名証IRエキスポ2025出展のお知らせ

2025年9月5日(金)、6日(土)に愛知県名古屋市の吹上ホールで開催される名証IRエキスポ2025に出展します。

この機会に当社へのご理解を深めていただけますと幸いです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

名証IRエキスポ2025の詳細はこちら

https://www.nse.or.jp/ir_expo/investor/

石徹白での活動紹介ビデオ8作目を制作

2025年4月に石徹白での活動紹介ビデオ8作目を当社ホームページに掲載しました。

森づくりの活動は、社員にも広がり新たなスタートを切りましたが、ここに至るまでに多くの方の支えがありました。8作目となる本動画は、活動を支えた方々に焦点を当てて制作しています。ぜひ、ご覧ください。

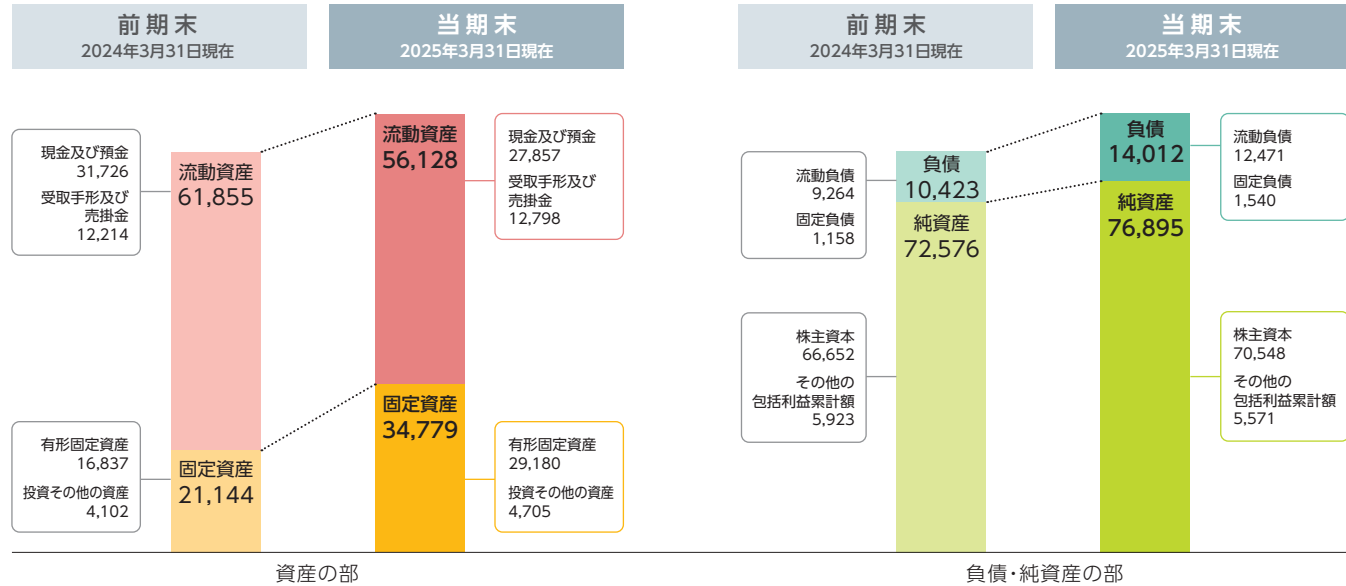


過去の作品をはじめ、こちらからご覧いただけます。

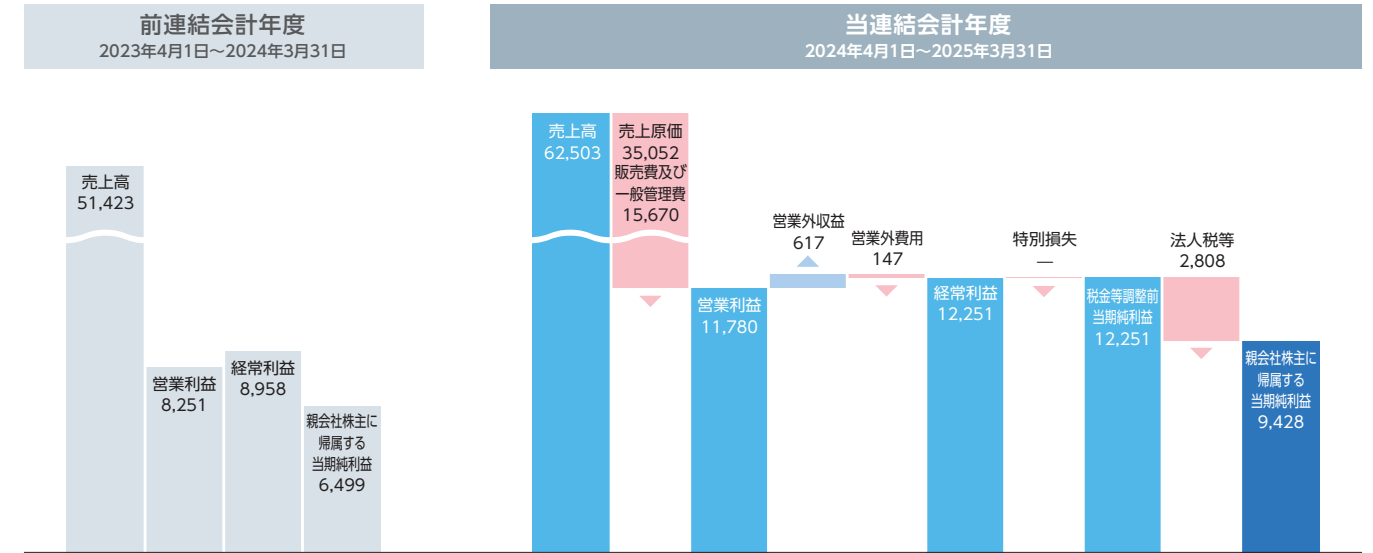
FUJIMI INCORPORATED広報チャンネル

<https://www.youtube.com/@fujimiincorporated5384>

連結貸借対照表の概要 (百万円)



連結損益計算書の概要 (百万円)



解説

総資産

前連結会計年度末に比べ、7,908百万円増加し、90,908百万円となりました。これは、現金及び預金が3,869百万円、有価証券が3,200百万円それぞれ減少したものの、建設仮勘定が7,497百万円、土地が3,357百万円、機械装置及び運搬具が1,380百万円それぞれ増加したこと等によるものです。

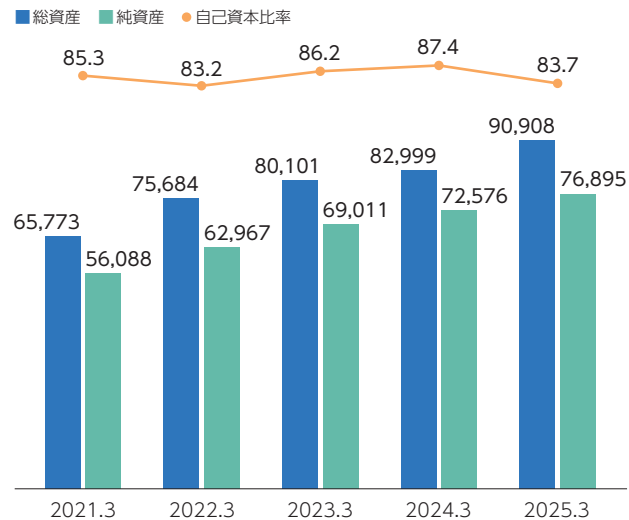
負債

前連結会計年度末に比べ、3,589百万円増加し、14,012百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が914百万円、未払法人税等が837百万円、設備関係未払金が814百万円それぞれ増加したこと等によるものです。

純資産

前連結会計年度末に比べ、4,319百万円増加し、76,895百万円となりました。これは、利益剰余金が3,895百万円増加したこと等によるものです。

総資産・純資産・自己資本比率 (百万円、%)



解説

売上高

半導体市場は、AI向け需要が牽引する一方で、パソコンやスマートフォン、車載向け等の需要は力強さを欠いており、全体としては依然バラつきが見られ、本格的な回復には今しばらく時間を要すると思われます。こうした状況下、主に当社の先端半導体向け製品の販売が増加したことに加えて円安により、売上高は前期比21.5%増の62,503百万円となりました。

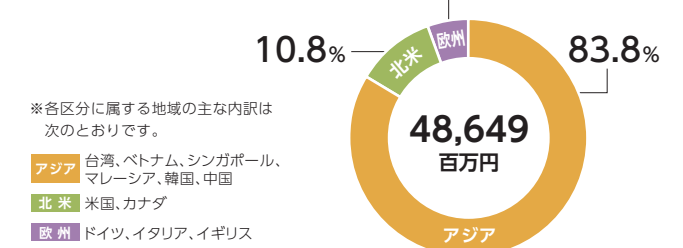
営業利益

前期比42.8%増の11,780百万円となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益

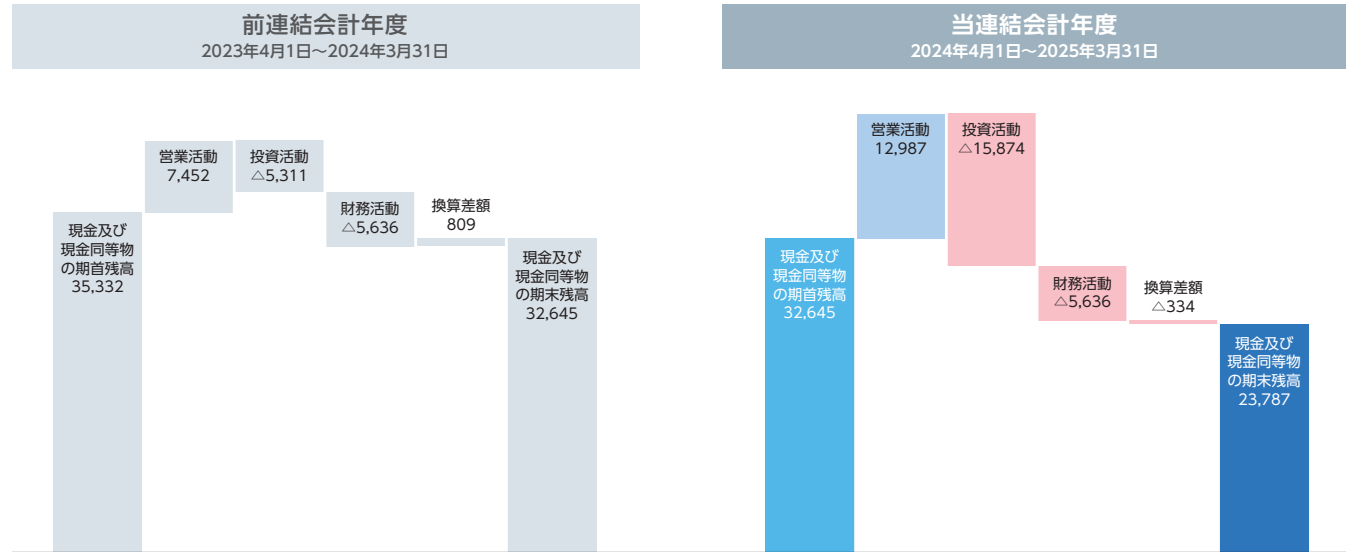
前期比45.1%増の9,428百万円となりました。

海外売上高(仕向先別)

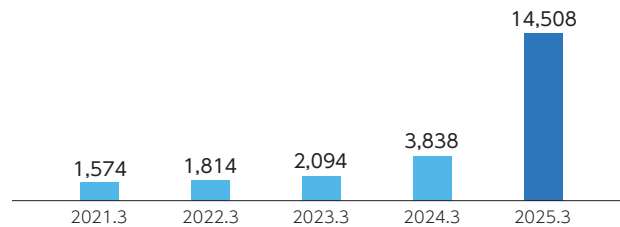


海外売上高	前期末 2024年3月31日	当期末 2025年3月31日
海外売上高 (百万円)	39,873	48,649
連結売上高 (百万円)	51,423	62,503
連結売上高に占める割合 (%)	77.5	77.8

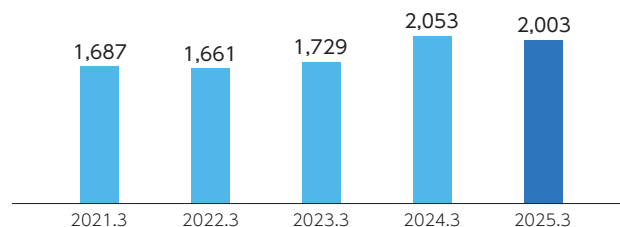
連結キャッシュ・フロー計算書の概要 (百万円)



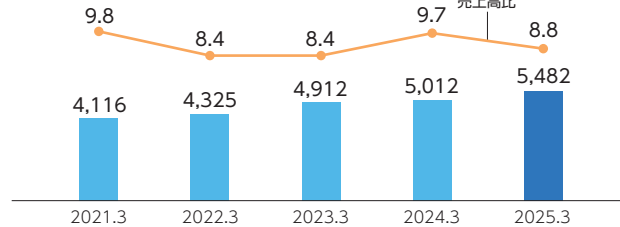
設備投資 (百万円)



減価償却費 (百万円)



研究開発費・売上高比 (百万円,%)



利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、配当につきましては連結配当性向を55%以上とすることを目標として、業績に応じた積極的な株主還元を実施するとともに安定配当の継続にも留意することを基本方針としております。このような方針のもと、当期末配当金につきましては、1株につき36.67円といたします。この結果、中間配当を含めた当期の配当金は1株につき73.34円となります。

株式情報 2025年3月31日現在

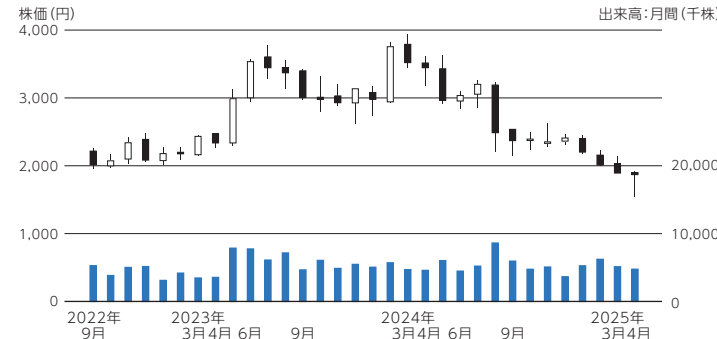
株式の状況

発行可能株式総数	320,000千株
発行済株式の総数	80,098千株
株主数	14,739名

大株主(株主名)	持株数(千株)*1	持株比率(%)*2
有限会社コマ	13,381	17.7
日本スタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	7,444	9.8
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	4,752	6.2
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	4,570	6.0
フジミ取引先持株会	1,942	2.5
日本生命保険相互会社	1,918	2.5
一般財団法人越山科学技術振興財団	1,800	2.3
株式会社三菱UFJ銀行	1,530	2.0
第一生命保険株式会社	1,417	1.8
関 敬史	1,323	1.7

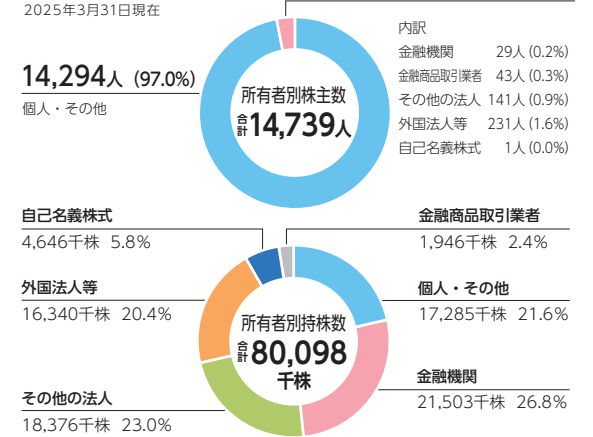
*1 持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てています。
*2 持株比率は、自己株式(4,646,167株)を控除して計算しております。

株価及び出来高の推移



(注) 2023年7月1日を効力発生日として、1株につき3株の割合で株式分割を実施しており、株価は調整後株価を表示しています。

株主分布状況



役員

2025年 6月24日現在

代表取締役社長	関 敬史
常務取締役	大脇 寿樹
常務取締役	鈴木 勝弘
取締役	日比 勝之
取締役	川下 政美*
取締役	吉村 温子*
取締役	山崎 直子*
取締役	石川 修平*
常勤監査役	藤川 佳明
監査役	岡野 勝**
監査役	柴田 和範**

*印は社外取締役 **印は社外監査役

会社データ 2025年3月31日現在

商号	株式会社フジミインコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL. 052-503-8181(代表)
設立年月日	1953年(昭和28年)3月20日
資本金	4,753百万円
代表者	代表取締役社長 関 敬史
従業員	1,235名(単体855名)